

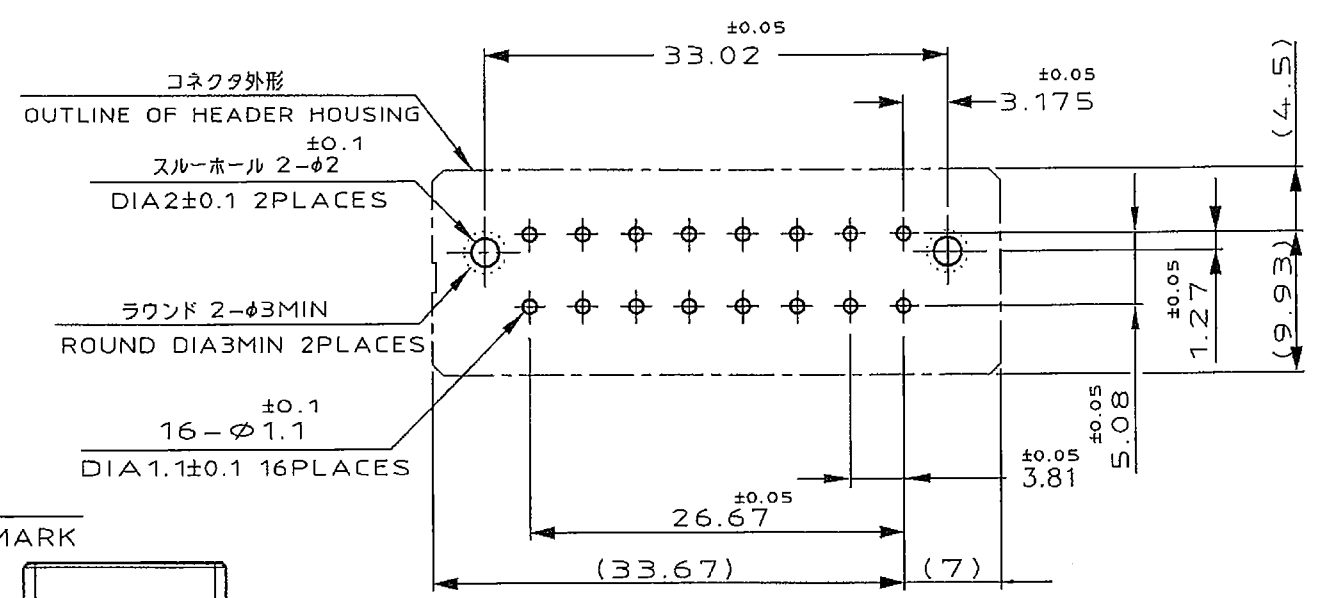
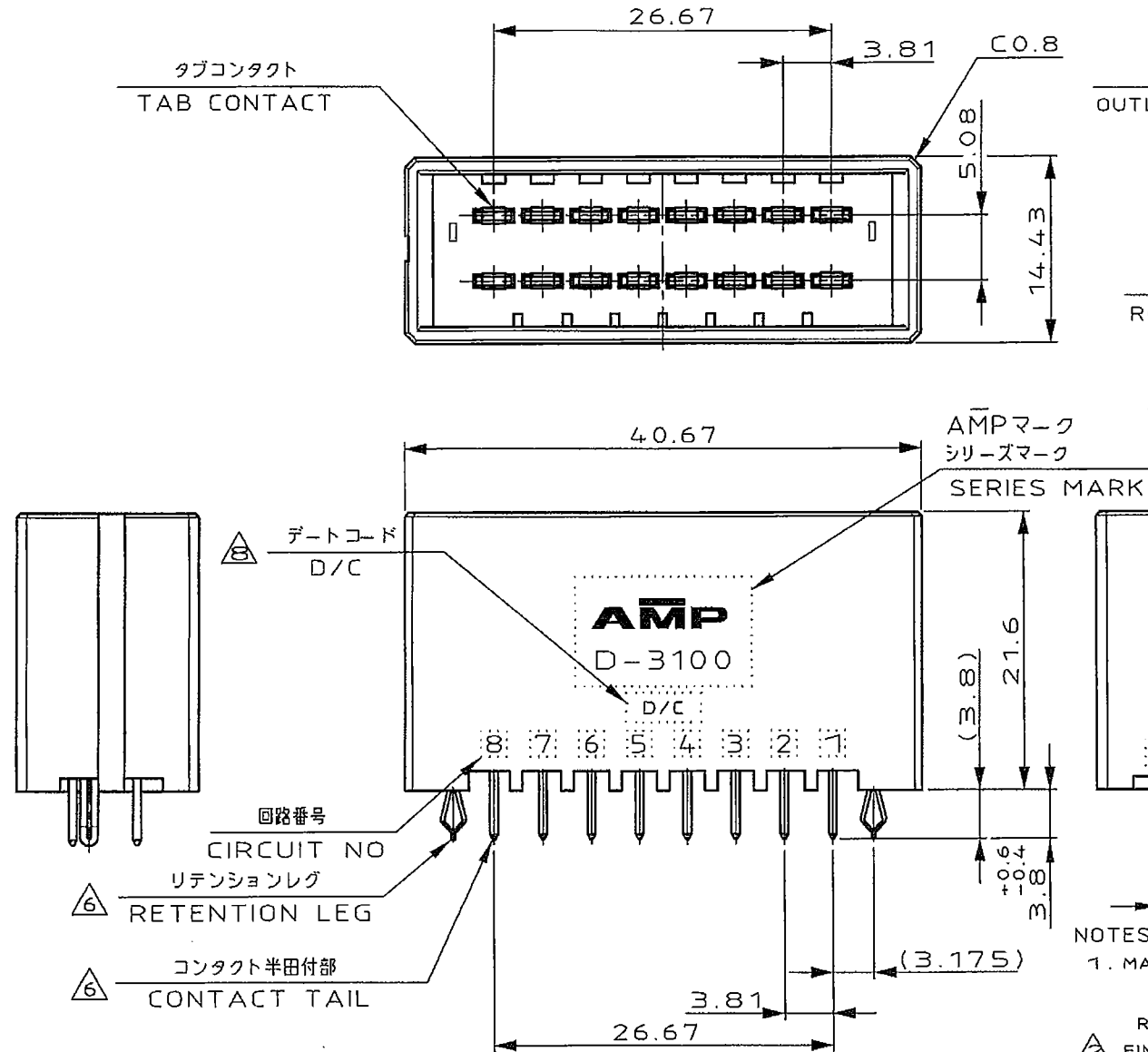
NUMBER
178327



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE THEY DON'T SHOW DETAILS
 - THE DATE CODE SHOW PRODUCTION LOT BY NUMBER. THE NUMBER MAKE UP THE NUMBER OF FOUR COLUMNS OR FIVE COLUMNS. (INCLUDE THE ALPHABET)

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき
 - 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません
 - 4桁の数字及びアルファベットを含む5桁の数字により製造ロットを示す。

△	△	178327-6
△	△	178327-5
△	△	178327-3
△	△	178327-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E3	REVISED	N.W.K.Z.X.X	DR.	19 APR 94	DE.	19 APR 94
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK.	APP.
					N. Matsubara	N. Matsubara
					S. MANABE	S. MANABE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME		
mm(AWG -)		mm		16 POS DOUBLE ROW		
MATERIAL		FINISH		VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100		
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC
				10% ±0.3	A3	J
				30% ±0.4		
				50% ±0.45		
				内径 ±3'	SCALE	REV.
					2-1	E3
						SHEET
						1 OF 1



(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)